臺北醫學大學　函

地　　址：110 臺北市信義區吳興街 250 號(信義校區)、235 新北市中和區圓通路 301 號(雙和校區)
承 辦 人：洪乙文
電　　話：(02)27361661 轉 8612
傳　　真：(02)27387348
電子信箱：sister@tmu.edu.tw

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 113. 07. 10 文
檔號： 113356

受文者：如正本單位

發文日期：中華民國 113 年 7 月 4 日
發文字號：北醫校進字第 1130011753 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：招生海報

主旨：檢送本校勞動部勞動力發展署產業新尖兵試辦計畫補助課程-產業新尖兵-輔具設計 3D 列印人才養成班(第 1 梯次)招生資訊如說明，敬請惠予公告，歡迎踴躍參加，請 查照。

說明：

一、依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 113 年 06 月 26 日北分署培字第 1134500747 號函辦理。

二、旨揭課程引領 5＋2 產業培養符合業界需求人才關鍵技術能力，本校規劃辦理「產業新尖兵-輔具設計 3D 列印人才養成班(第 1 梯次)」。

三、課程相關訊息

(一)參加對象：開訓當日應為 15 歲至 29 歲(含) 無就業且非日間部學生之青年。

(二)課程費用：符合資格條件及規定者，由勞動部勞動力發展署所屬分署依訓練單位辦理訓練收費標準，最高以補助 10 萬元為上限。培訓期間依據「失業青年職前訓練要點」發給學習獎勵金，每人每月最高可領 8,000 元學習獎勵金。

(三) 報名期間：即日起至 7 月 23 日止。

四、本處網站(https://reurl.cc/Rq3zl6) 即日起開放報名，檢附課程招生海報，敬請協助公告宣傳。

六、課程聯繫窗口: 本校進修推廣處洪小姐，報名問題請逕洽專

線：(02) 27361661 分機 8612、2419 或 Line 諮詢官方帳號 ID：@KGW5020L。

正本：新北市醫療器材商業同業公會、桃園市醫療器材商業同業公會、嘉義市醫療器材商業同業公會、台灣省醫療器材商業同業公會、臺南市醫療器材商業同業公會、臺北市醫療器材商業同業公會、台中市醫療器材商業同業公會、高雄市醫療器材商業同業公會、高雄市直轄市醫療器材商業同業公會、台南市直轄市醫療器材商業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、彰化縣醫療器材商業同業公會、屏東縣醫療器材商業同業公會、台灣口腔生物科技暨醫療器材產業發展促進協會、台灣牙科器材同業交流與公益協會、中華民國助聽器商業同業公會全國聯合會、桃園縣助聽器商業同業公會、彰化縣助聽器商業同業公會、中華民國儀器商業同業公會、嘉義市儀器商業同業公會、台中市儀器商業同業公會、臺北市儀器商業同業公會、高雄市儀器商業同業公會、桃園市儀器商業同業公會、新竹市儀器商業同業公會、臺南市儀器商業同業公會、中華生物醫學工程協進會、中華民國生物醫學工程學會、財團法人台灣醫學資訊學會、社團法人台灣生醫電子工程協會、台灣醫療暨生技器材工業同業公會、台灣顯示器產業聯合總會、台灣健康資訊產業整合協會、台灣健康資訊交換標準第七層協定協會、台灣數位安全聯盟、社團法人台灣電子設備協會、台灣生技醫療照護輔具協會、台灣醫療照護輔具協會、社團法人臺灣輔具產業發展協會、台灣康復技術交流協會

副本：

校長 吳麥斯

臺北醫學大學一一三年度推廣教育
輔具設計 3D 列印人才養成班(第 1 梯次)招生簡章

一、依　據：　勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署產業新尖兵計畫。

二、目　的：　教導學員學習輔具設計技巧及製造的概念，包含基礎視圖能力、電腦輔助設計軟體應用(如 Solidworks)，並熟悉 3D 列印技術，培養學員電腦輔助設計與 3D 列印的實務技術。

【結訓後可從事】

機械設計工程師、產品設計師、醫療器材設計工程師、設計繪圖人員、機構工程師、3D 列印工程師、電腦繪圖助理、構圖工程師、模具設計工程師、個人工作室等。

三、班　別：　輔具設計 3D 列印人才養成班(第 1 梯次)

四、對　象：　高中職(含)以上，且年滿 15~29 歲之本國籍失業青年非屬日間部在學學生，並符合產業新尖兵之補助對象。

五、上課期限：　113 年 08 月 01 日至 113 年 09 月 12 日，每週一至五(共計 165 小時)。

(每日上課時間配合課程略有調整，將依照實際課表為主)

六、收費標準：　新臺幣 52,400 元（符合「產業新尖兵計畫」補助資格參訓者，每人需先行繳交訓練自付額 10,000 元）

★經確認資格符合者，另行通知指定匯款帳戶，繳交自付額 1 萬元，並將匯款證明傳送至訓練單位指定電子信箱確認。

自付額補助規定:

青年出席時數應達總課程時數三分之二以上及取得結訓證書，且符合下列情形之一，應至台灣就業通本計畫專區申請自付額之補助，並經分署審查通過者，由分署直接將自付額補助撥入青年個人金融帳戶：

(一)結訓日次日起九十日內，已依法參加就業保險，且於結訓日次日起一百二十日內，上傳國內金融機構存摺封面影本等文件至台灣就業通本計畫專區。

(二)因服兵役致未能參加就業保險，應於結訓日次日起一百二十日內，上傳兵役徵集通知等證明文件，申請自退役日次日起計算依法參加就業保險之期日，且於退役日次日起一百二十日內，上傳國內金融機構存摺封面影本等文件至台灣就業通本計畫專區。

青年有下列情形之一者，不予補助自付額：

(一)未依第二項所定之期限提出申請。

(二)應檢附之文件不全，經分署通知限期補正，屆期未補正。

七、上課地點：　學科地址:臺北市信義區吳興街 250 號(臺北醫學大學信義校區杏春樓)

術科地址:臺北市信義區吳興街 250 號(臺北醫學大學信義校區杏春樓)

八、報名方式：　請依步驟完成

1.申請成為「台灣就業通」會員(請確實填寫電子郵件)。

2.於計畫專區完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗

(https://exam.taiwanjobs.gov.tw/JobExam/L03/L0301)。

3.完成線上簽署「報名及參訓資格切結書」，書面審查資料填寫及資格證件繳交。

4.依規定參加甄試及參訓。

九、報名日期:　113 年 07 月 01 日起至 113 年 07 月 23 日

十、招生名額：　25 人(最低 15 人開班)。

十一、甄選方式:　甄選日期 113 年 7 月 25 日。

(1)審查高中/職(含)以上畢業證書。

(2)年滿 15~29 歲高中/職(含)以上之本國籍失業青年且非屬日間部在學學生，並確定是否符合產業新尖兵計畫補助對象。

(3)依報名先後順序甄選，7 月 26 日下午 4 點電郵通知錄取。

十二、結訓證書發給條件：本班為非學分班，修讀時數為 165 小時，不授予學位證書，僅發給結訓證書。

(1)出席時數達課程總時數 2/3 以上

(2)完成小組專題報告

完成上述所有條件，可取得結訓證書。

十三、退費方式: 取消報名暨自付額退費規定

1.於開訓日前 3 日放棄資格者，自付款全額退款。

2.於開訓日前 2 日至開訓日當天，將退還八成自付款(收取兩成自付款將用於人力成本費、教材印製費、行政庶務費等)。

3.開訓日次日起取消報名，恕不退回一萬元自付額。

十四、其它事項: 【出缺勤】

(1)上午、下午之上下課應親自簽到退(一天簽 4 次)，

(2)簽名以中文正楷簽全名。

(3)上課時間逾 20 分鐘進教室，視為缺席 0.5 小時，請勿遲到早退。

(4)每天上午第一節課 20 分鐘內到課，無需填寫遲到時間，不計遲到缺席時數(給學員通勤上緩衝時間)

*****注意*****

只有上午第一節課有緩衝時間，為珍惜職訓補助資源，應準時到課。

(5)上午第一節課自第 21 分鐘起，須列入 0.5 小時缺課時數。

(6)請假單位以 0.5 小時計算，未滿 0.5 小時則以 0.5 小時計算，遲到或需早退時，務必於簽到表上加註晚到/早退時間(以 0.5 小時為單位填寫，如:10:28 到，請寫 10:30；13:47 到，請寫 14:00)。

【請假規定】

(1)請假請務必告知班導師請假日期及時段

(2)事假須於課程前一日通知班導師，若病假則於課程開始前半小時通知班導師，並於隔日補簽假單。

(3)未到課時數累計超過總課程時數三分之一，立即退訓。

【其他】

(1)上課期間有找到工作或其他因素要離訓時，請提前告知課務人員離訓原因及離訓日，並 MAIL 給訓練單位及北分署。

(2)上課期間勿打工加勞保，勞動部之尖兵系統會勾稽到勞保局的加保資料，訓中加保就不符此計畫規定，經發現屬實，加保日的前一次上課日即退訓日。

(3)青年參加本計畫訓練課程，出席時數應達總課程時數三分之二以上，出席時數未達規定者，一年內不得參加職前訓練。

(4)青年參加本計畫以一次為限，曾中途離訓、退訓或曾參加產業新尖兵試辦計畫者，不得再參加本計畫。

(5)**青年領取學習獎勵金，訓練期間未到課之時數，不得達全期訓練總時數 10%以上。**

.參訓未滿 30 日，不得領取學習獎勵金。

.青年因參加訓練課程而領取學習獎勵金，以 1 次為限。

.依法領取失業給付或職業訓練生活津貼，不得領取學習獎勵金。

十五、課程大綱：

科別	單元名稱	課程內容	時數	授課老師
其他	開訓典禮、入班宣導及班會	開訓典禮、班務管理、課程說明	3	洪乙文
其他	設計思考 1_小組專題討論	小組專題討論、專題製作小組討論	6	林立峯
其他	設計思考 2_小組專題討論		6	林立峯
其他	就業輔導及演講	優化履歷表撰寫、面試實戰演練 廠商人資人員演講	3	楊建中
其他	就業媒合	就業媒合	3	楊建中
一般學科	課程 Q&A	總結所有學科與術科教學內容 Q/A，分組指導專題報告作品之修改	3	楊建中
一般學科	期末專題製作	學員專題報告	9	楊建中
專業學科	基礎圖學	圖學基本概念、線條、幾何、正投影、輔助視圖、剖視圖尺度、展開圖等	12	楊建中
專業學科	工業 4.0	物聯網技術與現代製造思維、工業產品設計及製造流程介紹	3	梁雲龍
專業學科	設計專題介紹	輔具設計介紹、與製作流程	6	梁雲龍
專業學科	醫療儀器相關法規	醫療器材設計與開發流程管制	6	楊建中
專業學科	ISO 13485	醫療器材國際標 ISO 13485 品質系統	6	楊建中
術科	設計專題製作	輔具設計實務(1.日常餐飲2.生活居家3.外出移動)：外觀、人因工程、功能設計、功能零件、組裝、功能測試、設計流程檢討。	45	梁雲龍
術科	Solidworks 軟體	3D 繪圖之畫線、刪除與修剪、旋轉、環狀、鏡射、直線、草圖、參考幾何、基準面、基準軸、共用值、數學關係式、進階結合、工程圖指令說明、線性靜態分析、掉落測試分析和疲勞分析	42	楊建中
術科	3D 列印	電腦輔助設計(CAD)與 3D 列印配合與運用、3D 列印技術實務及演練	12	楊建中
總時數			165	

十六、就業輔導方式：

1. 請業界廠商辦理專題演講並媒合，面對面瞭解職務內容。
2. 就業輔導Q&A。
3. 履歷表撰寫練習。
4. 面試實戰演練。

十七、洽詢方式：

臺北醫學大學 進修推廣處(信義校區)

地　址：110台北市信義區吳興街250號

電　話：(02) 2736-1661 轉8612 洪乙文小姐

傳　真：(02) 8732-1699